

半導體工程系 進修部四技 112 學年度入學課程結構規劃表

課程類別	一年級						二年級						三年級						四年級							
	第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期			第一學期			第二學期				
	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數	課程名稱	學分數	時數		
校共同必修課程	應修學分數 10 學分	中文閱讀與表達(一)	2	2	中文閱讀與表達(二)	2	2																			
		實用英文(一)	2	2	實用英文(二)	2	2	實用英文(三)	2	2																
									體育(一)	0	2	體育(二)	0	2	體育(三)	0	2	體育(四)	0	2						
通識課程	博雅通識	人文與創意美感	博雅通識/學分數/時數																							
		科技與數位知能	博雅通識/學分數/時數																							
		社會與身心關懷	博雅通識/學分數/時數																							
		歷史與多元思維	博雅通識/學分數/時數																							
		全球與永續議題	博雅通識/學分數/時數																							
		通識微學分(一)1、通識微學分(二)1、通識微學分(三)1、通識微學分(四)1、通識微學分(五)1、通識微學分(六)1、通識微學分(七)1、通識微學分(八)1、通識微學分(九)1、通識微學分(十)1																								
必修	應修課程數 20 門/ 應修學分數 60 學分	微積分(一)	3	3	微積分(二)	3	3	電子學(一)	3	3	電子學(二)	3	3	半導體元件	3	3	微電子專題	3	3	單晶片實驗	3	3				
		電路學(一)	3	3	電路學(二)	3	3	微電子電路實驗	3	3	半導體材料概論	3	3	半導體製程	3	3	FPGA/HDL 設計實習	3	3							
		普通物理	3	3	數位邏輯實務	3	3	電腦輔助 電路設計實習	3	3	微電子應用 電路實驗	3	3	半導體量測實驗	3	3										
		計算機概論 (Office 軟體應用)	3	3	計算機與程式應用	3	3																			
系專業課程	選修	應修學分數 至少選修 48 學分	普通物理實驗/3/3 電腦網路概論/3/3 微控制器實務應用/3/3 電腦數值控制 CAD/CAM 實習/3/3 電腦網路概論/3/3 半導體封裝工程/3/3 工程數學/3/3 虛擬圖控儀表實務/3/3 嵌入式系統實習/3/3 數位系統應用實務/3/3 IC 產業介紹與應用/3/3 太陽能光電技術/3/3 半導體構裝材料與製程簡介/3/3 電磁學/3/3 統計學/3/3 真空系統/3/3 物聯網產業介紹與應用/3/3 半導體封裝可靠度分析/3/3 數位訊號處理/3/3 虛擬圖控儀表實務/3/3 工業經濟學/3/3 自動控制/3/3 感測元件應用電路實習/3/3 感測網路應用實務/3/3 發光二極體元件及其應用/3/3 半導體封裝可靠度分析/3/3 半導體封裝元件 EMI/EMC 分析/3/3 產業經濟學/3/3 訊號與系統/3/3 半導體封裝工程/3/3 產業問題導向學習/3/3 產業實務見習與總結/1/1 VLSI 設計/3/3 數位訊號處理/3/3 光電元件量測暨封裝實務/3/3 大數據資料庫應用實務/3/3 半導體封裝元件 EMI/EMC 分析/3/3 工業經濟學/3/3 半導體無塵室技術/3/3																							

備註：

- 一、畢業總學分數為 128 學分。
- 二、專業課程必修 60 學分，專業課程選修 48 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)
- 三、校共同必修課程及通識課程 20 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。
- 四、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：承認外系(非通識)選修學分至多 12 學分為專業選修，其中非本院開設之專業選修課程至多承認 6 學分。



113. 6. 06